

絶縁体の表面に形成される配線パターンへの カニゼンプロセス

セラミック基板



プリント基板



重金属フリー-SFB-26の特徴

- 独立配線上に Ni を被覆させることが可能
- Ni-B 合金皮膜は、還元力の強い DMAB を使用しており、配線上の被覆精度が良好
- 出来上がる Ni-B 皮膜は、融点が約 1,350℃であることで、高融点材料との密着を熱処理にて補うことが可能
- 還元剤に次亜リン酸ソーダを用いないため、リンに由来する酸化が無いことで、はんだ特性に優れている
- めっき温度が 60℃前後で使用できる
- Ni-P 皮膜と比較して、電気特性に優れている
- 均一で寸法精度に優れている

Pbフリー-SE-666の特徴

- 独立配線上に Ni を被覆させることが可能
- Cu 配線上に欠陥が無い緻密な皮膜を被覆させることが可能
- 出来上がる Ni-P 皮膜は、後工程での Au めっきとの相性に優れている
- 非硫黄添加物系のめっき液で、皮膜の耐蝕性に優れている
- 液の構成を、新しい方式を採用した CP 方式にて運用することが可能
【※CP 方式：PH 調整剤（苛性ソーダ）をユーザーサイドで調達を可能にし、コスト対策に寄与する方式】
- 均一で寸法精度に優れている